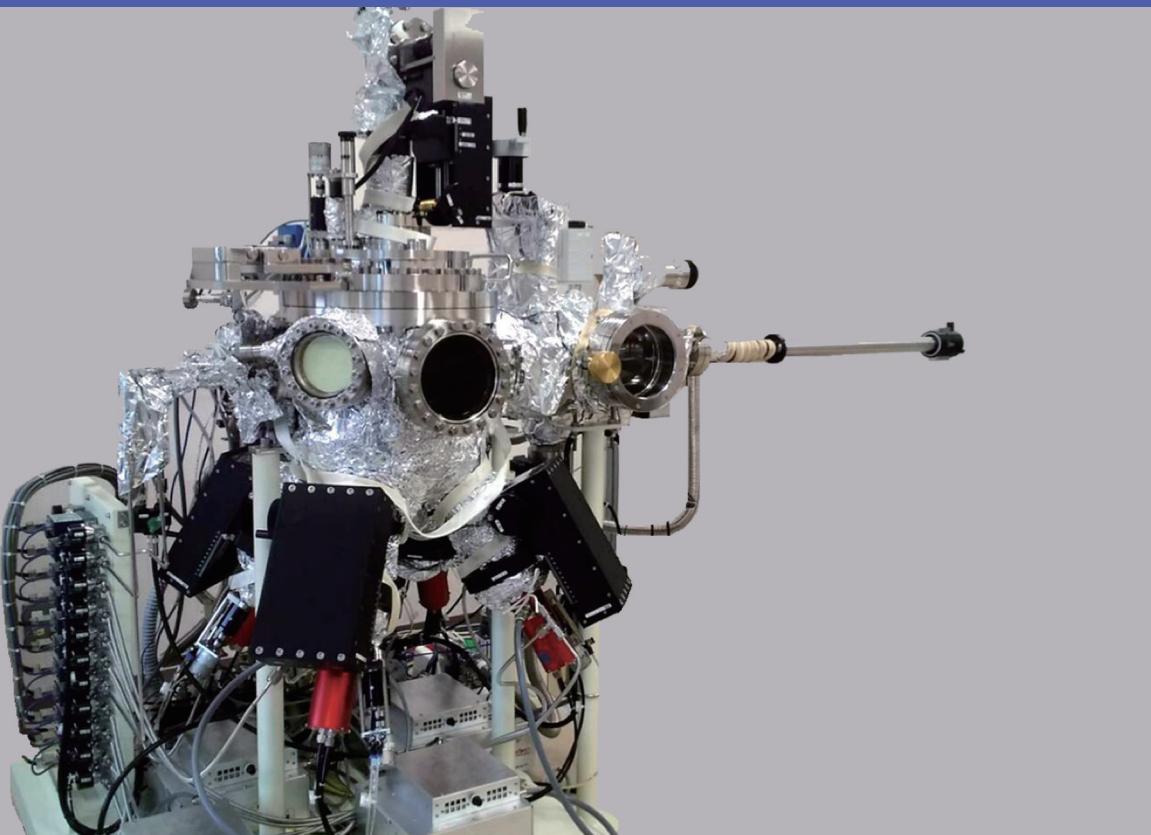




真空容器内に圧力勾配を用いたスパッタ技術



製品・技術の
名 称

真空容器内の圧力勾配現象を用いた 革新的スパッタ成膜技術

【概要】

真空容器内の圧力勾配現象を用いたスパッタ成膜技術は、高真空中で高密度プラズマを安定維持することができ、スパッタ粒子の平均自由行程を長くすることができます。基板からターゲットの距離が200mm以上で成膜することができ、従来スパッタ成膜技術の課題であった①プラズマによる成膜へのダメージ低減、②成膜速度の向上、③成膜品質の向上などの問題解決が可能です。この技術は複数の大学と共同研究のもと、高密度プラズマスパッタカソード、真空容器内圧力勾配の生成の2つの要素技術開発により実現し、特許出願と国内外の学会で継続的な成果発表をしています。

ここが ポイント!

圧力勾配現象により高真空中でプラズマを維持しスパッタ成膜を実現。
品質向上、最先端の機能性薄膜の開発に貢献する技術。

【参考価格】

1500万円～2500万円（1製品・技術当たり）

※表示価格は税抜きです。

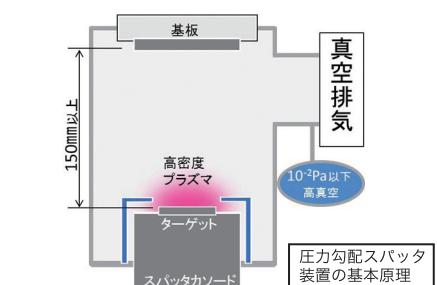
【企業 PROFILE】

ケニックス株式会社

代表取締役：米澤 健

Kenix

兵庫県姫路市北条口2丁目15番地 小山ビル501
Tel: 079-283-3150 / Fax: 079-280-3002
<http://www.kenix.jp/>



圧力勾配スパッタ装置は従来スパッタ装置に比べ、
高真空中で長い平均自由行程→基盤～ターゲットの距離長い
高密度プラズマで生成領域が小さく、基盤ダメージが少ない

企業からの一言 / PR ポイント

既知の普遍的装置技術であるスパッタ成膜分野で、国内大学共同研究による革新的な「圧力勾配スパッタ技術」を開発しました。技術特性・優位性を市場広く紹介し、先端開発分野を中心とする産業・社会貢献に努めます。